

弊社子会社の龍雲垂普恩科技股份有限公司が、SEMICON TAIWAN 2022 に出展致します。

日付:2022 年 9 月 14 日~9 月 16 日(3 日間)

会場:台北南港展覽館(Taipei Nankang Exhibition Center, Hall (4F))

Booth No.:L0930(4F)

パネル展示:

- a) Temporary Bonding / Debonding **TWS series** for Power Devices.
- b) Temporary Bonding / Debonding **TWH series** for Advanced Package.
- c) Nanoimprint Lithography **Dyad™ series**.
- d) Panel Level Package Equipment **TZ series**.
- e) Clean Robot System **TT301A series** and **ET New series**.
- f) Pre-Aligner for Silicon Wafer(Backside VAC chucking) **MAF-R series**
- g) Phosphoric Acid Reclaim System **PSYRION®**
- h) Wet Single Cleaning & Etching System **CENOTE®**

ご来場の際は、是非弊社ブースへお立ち寄り下さいます様、お願い申し上げます。

以上